

Hyper Photonix、次世代 1.6T SiP 光トランシーバを OFC2026 で初公開 - マルチコアファイバー接続で AI インフラの拡張課題に応える -

[米カリフォルニア州ロサンゼルス] – 株式会社サイフィックス（日本）のグループ会社である Hyper Photonix は、米ロサンゼルスで開催される OFC 2026 に出展し、200G/レーンのシリコンフォトニクス（SiP）技術を採用した次世代 1.6T 光トランシーバ製品を初公開します。あわせて、4 コアのマルチファイバー（MCF）上で動作するライブデモを行い、AI を基盤としたインフラにおける帯域や接続密度の課題に対する新しいアプローチを紹介します。

Hyper Photonix ブース(#449)では、以下のライブデモンストレーションをご覧ください：

- AI 用途に適した 200G/レーンの高性能動作
- 安定した信号品質と優れた電力効率
- 次世代データセンターに対応するスケーラブルな設計
- 高負荷環境下でも安定した熱性能
- 総スループット 1.6Tbps
- MPO-12 コネクタを用いた試作インターフェース

（より高密度な MMC-16 コネクタを採用した量産製品を 2026 年第 3 四半期に投入予定）



本デモでは、SiPhx Inc.が提供するマルチコアファイバー（MCF）モジュール技術、Hyper Silicon™技術、Corning®のマルチコアファイバーを組み合わせ、高帯域と配線効率の向上を実現します。これにより、ケーブルの軽量化・小型化、配線管理の効率化、エアフロー改善、設置の簡素化が実現され、大規模 AI ネットワークにおける総コストの低減に貢献します。

2026年第2四半期に量産開始、製造能力を拡張

同社は、1.6T SiP トランシーバ製品を 2026 年第 2 四半期に量産開始予定です。これに合わせ、自動化を強化した製造インフラへの投資を進めています。

Hyper Photonix は、以下の新拠点を整備しています：

- 中国・杭州：第 2 の量産工場（2026 年 5 月稼働予定）
- メキシコ・モンテレイ：北米製造拠点（2026 年第 3 四半期開設予定）
-

これにより、2026 年の月間生産能力は 20 万台以上に拡大する見込みです。アジアの主要ハイパースケール事業者との商用実績を背景に、今後の需要拡大に対応します。

サイフィックス及び Hyper Photonix は、次世代マルチコアトランシーバのエコシステム構築に積極的に取り組んでいます。本デモは、マルチコアファイバーのエコシステム構築に向けた業界全体の取り組みの一環です。Corning のブース（#1739）では、ファイバー、ケーブル、接続までを含むエンドツーエンドのマルチコアソリューションが展示されます。また、EXFO は BA1600 ビットエラー測定器を用いた評価デモを行い、4 コア MCF リンク上での Hyper Photonix および他社トランシーバとの相互接続性を示します。



株式会社サイフィックス/Hyper Photonix は、高速・省エネルギー・低遅延の光通信技術を開発・提供するグローバル企業です。世界中のデータセンターや AI・機械学習のインフラを支える次世代通信ソリューションを展開しています。

〈お問い合わせ先〉

株式会社サイフィックス

<https://siphx.com>

茨城県つくば市筑穂 1-14-2

info@siphx.com

Hyper Photonix Unveils Next-Generation 1.6T Silicon Photonics Transceiver at OFC 2026 — Addressing AI Infrastructure Scaling Challenges with Multicore Fiber Connectivity —

[LOS ANGELES, CA] — Hyper Photonix, a group company of SiPhx Inc. (Japan), will exhibit at OFC 2026 in Los Angeles, where it will unveil its next-generation 1.6T optical transceiver based on 200G/lane silicon photonics (SiP) technology. The company will also present a live demonstration operating over 4-core multicore fiber (MCF), showcasing a new approach to addressing bandwidth and connectivity scaling challenges in AI-driven infrastructure.

Live Demonstrations at Hyper Photonix Booth (#449)

Visitors to Booth #449 will see live demonstrations featuring:

- High-performance 200G/lane operation optimized for AI workloads
- Superior signal integrity and power efficiency
- Scalable design for next-generation data center networks
- Robust thermal performance under demanding conditions
- 1.6 Tbps aggregate throughput
- Prototype interface using an MPO-12 connector

(A production-ready version with a higher-density MMC-16 connector will be introduced in Q3 2026)



The demonstration combines multicore fiber (MCF) module technology provided by SiPhx Inc., Hyper Silicon™ technology, and Corning® multicore fiber to deliver both high bandwidth and improved cabling efficiency. This approach reduces cable size and weight, simplifies cable management, improves airflow, and streamlines installation, ultimately lowering the total cost of large-scale AI network deployments.

Volume Production in Q2 2026 and Expanded Manufacturing Capacity

The company expects to begin volume production of its 1.6T SiP transceivers in Q2 2026, supported by significant investment in highly automated manufacturing infrastructure.

Hyper Photonix is expanding its manufacturing footprint with two new state-of-the-art facilities:

- Hangzhou, China: Second high-volume manufacturing site (scheduled to begin operations in May 2026)
- Monterrey, Mexico: North American manufacturing site (planned for Q3 2026)

These expansions are expected to increase monthly production capacity to over 200,000 units in 2026. Building on commercial success with leading hyperscale customers in Asia, the company is well positioned to meet growing global demand.

SiPhx and Hyper Photonix are actively contributing to the development of the next-generation multicore transceiver ecosystem. This demonstration is part of a broader industry effort to establish a complete multicore fiber ecosystem.

At Corning's booth (#1739), visitors can explore an end-to-end multicore solution spanning fiber, cable, and connectivity. In addition, EXFO will present testing demonstrations using its BA1600 bit error rate tester, highlighting interoperability between Hyper Photonix transceivers and those of other vendors over a 4-core MCF link.



About SiPhx/Hyper Photonix: SiPhx/Hyper Photonix is a leading provider of advanced optical networking solutions, dedicated to enabling high-speed, low-latency, and cost-effective connectivity for data centers, AI/ML infrastructure, and next-generation network architectures.

Contact:

SiPhx, Inc.

<https://siphx.com>

info@siphx.com